



RE901

- Placa de circuito impreso de multiadaptador con seis circuitos de semiconductor en microminiatura
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Superficie terminal química de Ni/Au y una máscara de inhibidora de la soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- En la placa de circuito impreso se pueden incorporar veinte tipos distintos de semiconductores indicados en la tabla
- Conexión de regleta de clavijas de 8 polos trama de agujeros 2,54 mm
- Diámetro de agujeros 1,00 mm
- Punto de ruptura controlada premarcado para separar los módulos
- Datos (Gerber) de curtiación para la fabricación de la máscara de soldadura y de la impresión de la pasta de soldadura se pondrán a disposición gratuitamente bajo demanda
- Tamaño 22,86 mm x 46,72 mm

Layout	Pad (mm)	Pitch	Tamaño	Configuración	Ocupación
TO252	*	*	*	*	TO252
SOT223	*	*	*	*	SOT223
SOT89	*	*	*	*	SOT89A
SOT23	0,710 x 1,000	0,950 mm	2,400 mm	2 Reihen x 3	SC59, SC74, SC74A, SMT3, SMT5, SMT6, SOT23, SOT23-5, SOT23-6
SOT23-8	0,460 x 1,100	0,650 mm	2,400 mm	2 Reihen x 4	SC70, SC88A, SOT23-8, UMT3, UMT5, UMT6
SC75	*	*	*	*	EMT3, SC75